

デンソー出資のS i C コヒレントCEO「EV用、安定供給へ」

デンソーと三菱電機が炭化ケイ素（S i C）事業への出資を決めた米半導体ウェハーメーカー、コヒレントのビンセント・マッテラ会長兼最高経営責任者（CEO）がN I K K E I M o b i l i t yのインタビューに応じた。S i C基板の需要は増える見通しで、「メーカーへの安定供給を通じて、電気自動車（EV）の日米サプライチェーン（供給網）を強化する」と語った。

コヒレント 光電子部品の製造大手で、レーザー技術に強みを持つほか、半導体ウェハーなど素材も手掛ける。2023年6月期の売上高は51億ドル（約7700億円）。

■『ものづくり』が信頼性に

——デンソーと三菱電機からそれぞれ5億ドル（約750億円）の出資（各12.5%の株式取得）を受けます。

「S i Cの事業を分社する。コヒレントはその75%を所有し、支配権を維持する。デンソーと三菱電機からの投資により、製造設備の増強や規模拡大に必要な製造技術の開発を進める。2027年ごろにウェハー（基板）サイズが200mmの製造が本格化する。提携を通じて規模を拡大していき、27年以後に年20%の売上高成長を達成する」

「ユーザー企業と長期的な供給契約を結ぶことで生産性を高められる。デンソーと三菱電機が生産規模を拡大すると、2社が素材についての知見を得る。その知見がフィードバックされ、製造技術の改善につながる。顧客サプライヤーとの協業を通じて、自社の技術を磨く。『ものづくり』は効率的で制御された工程技術が必要で、それが製品の性能と信頼性の向上につながる」

——なぜS i C事業を分社化するのでしょ

「外部からの投資を受けるための最も効果的な方法は、別会社を作ることだと考えた。投資した資金がS i C事業にのみ使われているということに役立つためだ。自社の生産能力や計画についての透明性を高める。一方で新会社はコヒレントが支配権を持ち、コヒレントが管理する」

■出資に多くの企業に関心

——日本に生産拠点を設置する構想はありますか。

「日本でS i Cを製造する計画はなく、販売やサービスに重点を置いている。顧客とのコミュニケーションを緊密にし、スピードを高める。しっかりとした物流体制をつくり、製品の納入を的確に保証できるようにする。S i Cや化合物半導体、レーザー技術など日本産業のエコシステム（生態系）との関係を深めていく」

——経済産業省が半導体産業の育成に多額の補助金を出しています。

「日本政府の政策については承知している。どんな事業機会があるのかを追求し、理解することが重要だ」

——出資するのは2社だけでしょうか。追加出資を募

る可能性はあるのでしょうか。

「デンソーと三菱電機による出資契約を締結してから6カ月以内は、5億ドルの追加出資を実行できる。結果はどうなるかは分からないが、多くの投資家が集まる機会



が生まれる。今回の出資には多くの企業に関心を寄せてきた。予測はできないが、まだ何社かが興味を持っている可能性はある」

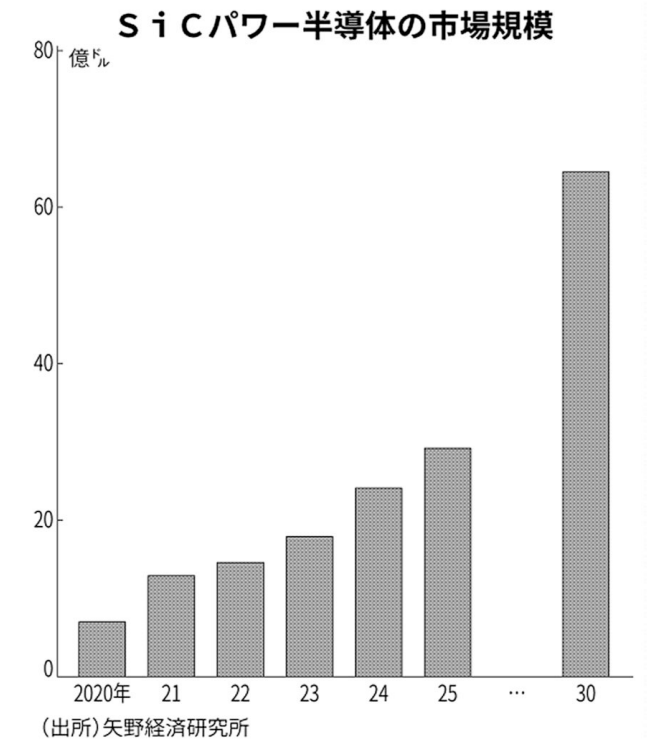
■2030年へ指数関数的に

——特定企業が出資することで、供給先が限られるリスクはありませんか。

「すべての顧客に対して、以前と同様に成長を続けることで市場に貢献していくという意向を伝えている。資本が充実していることは顧客にとって良いニュースだ」

——市場拡大のけん引役は。

「S i Cが半導体市場に占める割合は小さいが、2030年



に向けて指数関数的に増えていくと考えている。特にEVを中心に市場が拡大しているが、生成AI（人工知能）の出現でさらに多くの電力が必要になる。より効率的に電力を制御することが求められるようになる」

——新会社の名称はどうなりますか。新規株式公開（IPO）の予定は。

「子会社名は『シリコン・カーバイド（炭化ケイ素）』とする。将来は別の名前になるかもしれない。IPOの可能性はあるが、まだ可能性に過ぎない」

（広井洋一郎、小西夕香）

＝11月7日公開N I K K E I M o b i l i t y